

**Sn-3.5Ag 무연솔더와 열전재료 젖음계면 확산에 대한 조직의 영향**  
**Influence of Micro Structure on Wetting Interface Diffusion between Sn-3.5Ag Lead-free**  
**Solder and Thermo-electronic Material**

방한서, 이명우  
 조선대학교 항공조선공학부

## 1. 서론

BiTe 계 열전모듈은 다수 열전 소자를 진열실장하여 구성되는데 그 실장방법은 주로 솔더링이 채용되고 있다. 이 솔더링 공정에는 무연솔더가 응용되고 있어나 융점이 Sn37Pb 보다 높음으로 접합부 계면의 확산이 심하며 솔더링 접합부의 신뢰성을 낮춘다. 그러므로 가열시 무연솔더와 BiTe 계 열전재료 젖음계면의 용해 및 확산특징 그리고 이에 대한 영향요소의 검토는 열전모듈의 품질재고에 유익하다. 본 논문은 Sn-3.5Ag 무연솔더와 BiTe 계 열전재료 주조 및 단조물 젖음계면의 확산특징을 관찰하고 주조 및 단조재료의 조직과 가열조건의 영향을 검토하였다.

## 2. 실험재료 및 실험방법

Sn 베이스의 무연솔더중 Sn-Ag 계 솔더가 양호한 역학성능과 낮은 융점으로 인해 폭넓게 응용되고 있다. 본 연구는 Sn-3.5Ag 공정솔더가 채용되었으며 융점은 221°C다. 플렉스는 RMA 형이 채용되었다. 열전재료는 BiTe 계이다.

정밀가열 장치(정밀도: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ )를 이용하여 Sn-3.5Ag 공정 무연솔더의 주조 및 단조열전재료표면에서 젖음실험을 진행하였다. Fig.1 은 실험재료를 도식적으로 나타내었다. 표 1 은 열전재료와 솔더의 싸이즈를 나타내었다.

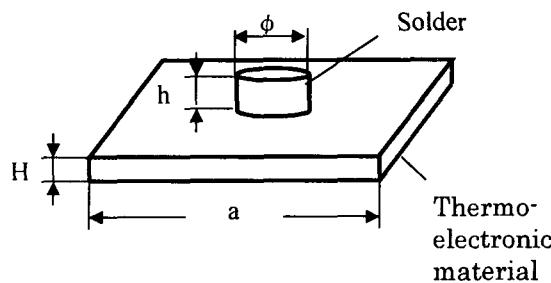


Table 1 The size of thermo-electronic material and solder

Parameters	a	H	φ	h
Size,mm	4	1	1	1

Fig.1 Schematic diagram of specimen

가열온도를 240°C, 그리고 가열유지시간을 30 분으로 설정하여 젖음 실험을 진행하였다. 실험한 시편의 절단면을 EPMA 를 이용하여 젖음 계면의 확산현상을 관찰하고 SEM 를 이용하여 주조 및 단조열전재료의 조직특징을 관찰하였다. 가열시간을 각각 0 분, 5 분, 10 분, 20 분, 30 분으로 설정하여 솔더의 열전재료에 대한 젖음 실험을 진행하여 젖음 계면의 확산규율을 검토하였다.

### 3. 결과 및 고찰

#### 3.1 젖음계면의 솔더 확산 특징

Fig.2 는  $240^{\circ}\text{C} \times 30\text{min}$  가열 조건 하에서 Sn-3.5Ag 무연솔더와 주조 및 단조 열전재료 젖음 계면의 반사전자 이미지를 나타내었다. Fig.2로부터 주조 및 단조 열전재료와 Sn-3.5Ag 무연솔더의 젖음 계면에는 솔더의 확산이 발생됨을 알 수 있다. 그러나 주조재료에서 솔더의 확산두께가 약  $60\mu\text{m}$ 이고, 단조재료에서 확산두께가 약  $200\mu\text{m}$ 라는 차이가 있음을 알 수 있다. 즉 단조열전재료에서 솔더의 확산정도가 심함을 알 수 있다.

동일한 가열 조건에서 솔더와 주조 및 단조열전재료의 젖음계면 확산결과의 차이를 분석하기 위하여 주조 및 단조열전재료의 금속조직을 관찰하였다.

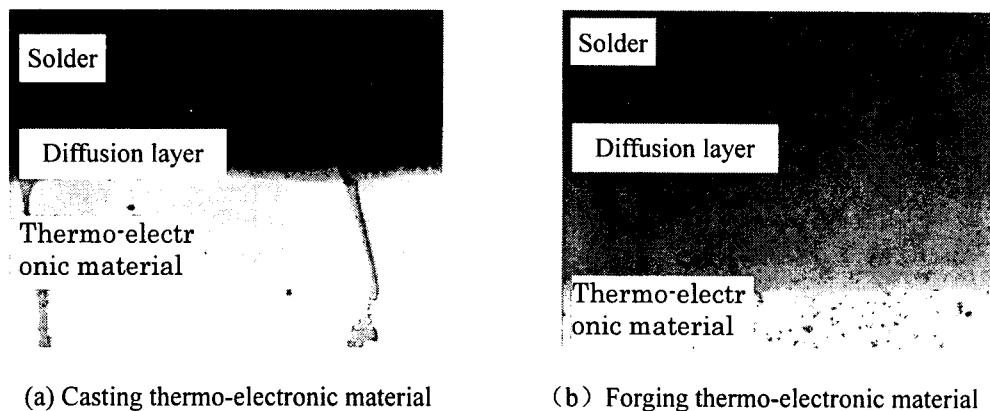


Fig.2 Reflection electron image of solder wetting interfaces

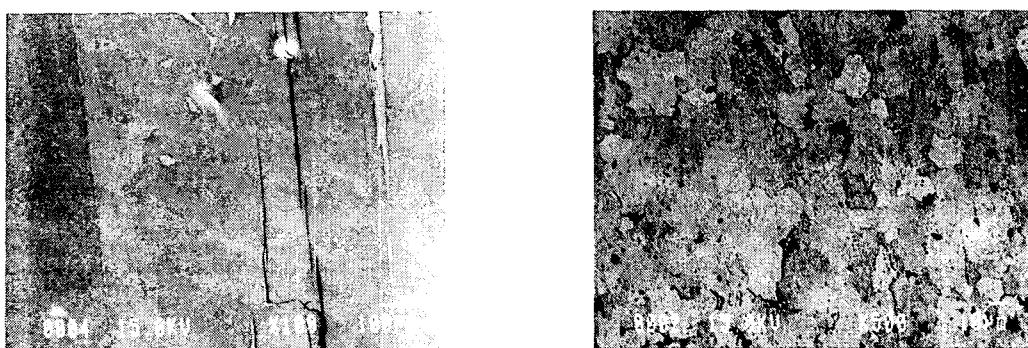
#### 3.2 열전재료조직

Fig.3 는 BiTe 계 열전재료 주조 및 단조모재의 조직사진을 나타내었다. 주조열전재료의 조직이 조대화함을 알 수 있으며 이로 인해 용융솔더가 모재로 확산할수 있는 경로가 적으로 솔더의 확산이 제어되었음이 확인된다. 단조열전재료의 조직은 fine 한것을 알 수 있으며 이로 인해 용융솔더가 확산할수 있는 경로가 많으므로 Sn-3.5Ag 무연솔더의 단조재료에 젖음확산 두께가 주조재료보다 크다는것을 알수있다.

#### 3.3 확산두께에 대한 가열시간의 영향

용융무연솔더의 열전재료에 확산은 열전재료의 성능에 영향을 줄뿐만아니라 열전재료 접합부 신뢰성에 영향을 주기때문에 상이한 가열조건하에서 확산의 규율을 검토하여 용융솔더의 확산을 제어할 필요성이 있다.

Fig.4 는 가열온도  $240^{\circ}\text{C}$ 조건하에서 Sn-3.5Ag 무연솔더의 열전재료 주조 및 단조물에 대한 확산규칙을 나타내었다. 확산층의 두께는 가열시간이 길어짐에 따라서 커지고 있다. 이 실험결과로부터 확산층 두께를 제어하기 위해서는 짧은 가열시간이 필요하며 본 논문의 연구결과, 가열시간을 5 분으로 추천한다.



(a) Casting material

(b) Forging material

Fig.3 Micro structure of thermo-electronic materials

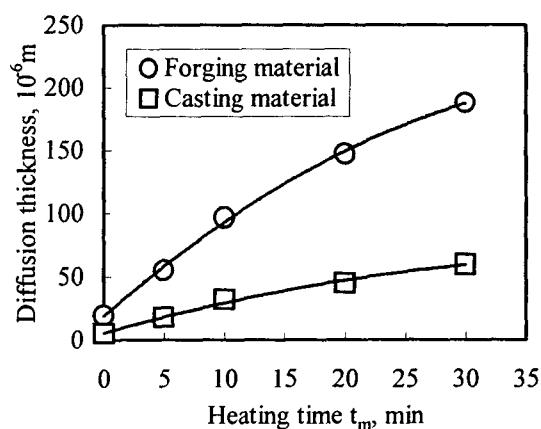


Fig.4 Influence of heating time on diffusion layer thickness at 240°C

#### 4. 결론

- (1) 240°C 가열조건 하에서 Sn-3.5Ag 무연솔더와 BiTe 계 열전재료 젓음계면에는 두꺼운 확산층이 생성되는 것과 단조물의 확산층 두께는 주조물보다 두껍다는 것을 알게 되었다.
- (2) 주조열전재료의 조직은 조대화 하므로 솔더의 확산 경로가 적다. 그러나 단조물은 조직이 세립화 하므로 솔더의 확산 경로가 많으므로 확산층 두께가 크다.
- (3) 가열조건을 240°C, 5 분으로 설치하면 젓음재고와 솔더 확산제어에 유익하다.

#### 참고문헌

1. Gu Yongming, Guo Yanming: The Optimizing Preparation Technology of the High Merit Figure P-type(Bi<sub>X</sub>Sb<sub>1-X</sub>)<sub>2</sub>Te<sub>3</sub> Thermoelectric Materials, Journal of Shanghai University, 15-3(1999), pp30-36
2. UK Patent Application GB 2253942.2